

证券代码： 002449

证券简称：国星光电

## 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260706

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	信金控股、中信私募、中信证券、国融证券、华泰证券、兴业证券、财信证券、招商银行、顺德科创等投资机构及个人投资者
时间	2026年7月6日（星期一）15:00-17:00
地点	佛山市禅城区华宝南路18号一楼115会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总裁 郭豪杰 2、董事会秘书 李文强 3、研究院 赵龙博士
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司高端光耦产品的核心竞争优势？相较于海外品牌的替代进度与渗透空间？</p> <p><b>公司回复：</b></p> <p>光耦是公司重点培育的战略型产品，也是国产替代核心赛道之一。公司光耦核心优势体现在三个方面：一是产品矩阵丰富，覆盖晶体管、可控硅、高速、继电器等主流光耦品类；二是性能与可靠性达标，核心产品通过UL、VDE、CQC等权威认证，适配工控、储能、新能源汽车、数据中心等高可靠性场景；三是具备产业链协同优势，依托公司光电封装技术沉淀，在成本控制、交付周期及定制化配套方面具备竞争力。目前公司光耦产品已稳定量产，国产替代进程加快，公司将继续加大投入，力争提升出货占比。</p> <p>2、公司再融资目前进展如何，预计何时能够完成？</p> <p><b>公司回复：</b></p> <p>公司本次再融资项目2026年5月已取得证监会同意注册批复，批复有效期12个月，本次定增发行方式为竞价发行，募集资金用于发展主营业务。目前公司正积极开展投资者推介路演，后续将综合考量二级市场情况，发行窗口及投资者反馈择机启动发行，公司将根据发行进展和监管规则及时履行信息披露义务。</p>

**3、近期市场较为关注的玻璃基板等相关产业热点，请问公司是否具备相关技术储备或业务布局？**

**公司回复：**

公司有基于AM驱动玻璃基Mini和MicroLED显示的相关技术储备，研发的1.84英寸Micro LED全彩显示屏--nStar III，采用LTPS-TFT玻璃基驱动背板技术，具备高分辨率、高亮度和强光下的清晰显示能力。

**4、公司和华为的联合创新中心成立至今，取得了哪些进展？**

**公司回复：**

自联合创新中心成立以来，双方在智能穿戴、闪光灯、指示产品、车载LED等领域持续推进合作深化，部分产品实现批量出货。双方依托联合创新平台协同攻关行业技术难点，持续推动前沿技术产业化落地，助力LED相关领域国产化替代进程。后续若相关合作达到法律法规规定的披露标准，公司将按要求履行信息披露义务。

**5、公司的车载LED相关产品包含哪些？目前车载业务的落地、定点及量产进展情况如何？如何看待该业务未来的增长空间？**

**公司回复：**

车载LED业务是公司重点布局的战略增长赛道，产品已覆盖车外灯、抬头显示（HUD）、交互显示、车用背光等场景。公司车规级照明LED、背光LED、陶瓷LED均已量产，交互显示已搭载于智己、领克等新能源车型；照明LED、背光LED在比亚迪、一汽、长安、五菱等车型上得到应用。行业机构预测，2030年车用照明与车用LED市场规模分别成长至470.70亿美金与45.12亿美金（数据来源：TrendForce）。叠加汽车产业链的国产化趋势，预计车载LED将迎来广阔的应用空间，为此公司推出“智能车载器件及应用建设”的募投项目应对市场需求，提升高附加值业务占比。

**6、Micro LED光互联作为算力时代核心赛道，请问公司是否具备切入该赛道的能力？**

**公司回复：**

公司拥有LED外延芯片、先进光电封装的垂直产业链体系，在Micro LED光互连赛道具备丰富的技术储备与产业基础。公司子公司国星半导体深耕LED外延、芯片制造十余年，产品对标行业主流芯片厂商，可提供Micro LED外延片与芯片阵列。

目前公司内部Micro LED光互联团队正在稳步推进产品的制造与送样测试工作，后续公司将持续跟踪Micro LED光互联产业的发展趋势，积极对接上下游产业链资源，开展新型光电封装领域的合作。

	<p><b>7、公司近期亮相上海慕尼黑电子展，有哪些新产品？</b></p> <p><b>公司回复：</b></p> <p>光耦方面，公司展出了晶体管光耦与可控硅光耦系列，助力国产替代。其中DIP系列可控硅光耦具备 5000Vrms隔离耐压，并在-55° C至 125° C超宽温区范围内保持稳定工作能力，适应高寒到高温的严苛场景；SSOP系列晶体管光耦器件采用轻量化封装，为智能家电、电源管理等对空间与可靠性要求极高的领域，提供“小巧且可靠”的解决方案。</p> <p>在智能光电子方面，公司展出了智能传感系列器件、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、LED闪光灯、紫外LED器件及指示灯系列产品，一站式满足客户的多场景感知需求。其中VCSEL产品主要应用于手机屏下、人脸识别场景，批量供货国内头部手机厂商。同时也可应用于 3D传感与激光雷达，应用前景广阔。</p> <p>在功率半导体方面，子公司风华芯电展出了氮化镓（GaN）与碳化硅系列产品及系统集成方案。其中氮化镓产品借助合封及扇出封装等技术，面向新能源汽车、储能及工业自动化场景，提供更高效率、更小体积的产品方案。碳化硅器件依托先进封装工艺与多芯片集成能力，在散热、耐高压及抗干扰性能上表现突出，适用于高压平台与工业伺服等应用环境。</p> <p>在超高清显示方面，公司实现“器件—模组—整机”全链条贯通，带来全场景MIP创新产品，包括MIP大屏一体机、MIP超微间距模组、弧形MIP软模组等产品。产品适配家庭影视、会议、安防监控、专业影音、商业展陈、曲面墙、电影院、世界杯体育场馆、虚拟拍摄等多元场景。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>